

FKZCONNECTOR

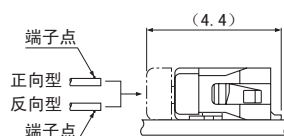
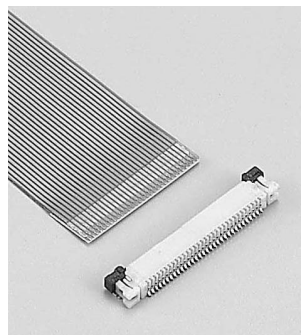
ZIF SMT型

- 省空间化
- 低背化

0.5mm
间距

■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20m Ω 以下
环境试验后/40m Ω 以下
- 绝缘电阻: 100M Ω 以上
- 耐电压: AC 200V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/0.5mm
导体宽度/0.35mm
接触部厚度/0.30 $\pm$ 0.05mm



FMCONNECTOR

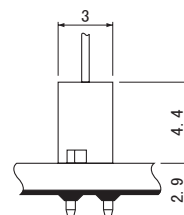
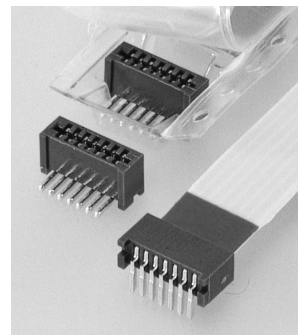
Non-ZIF SMT/DIP型

- 厚度为3.0mm的紧凑设计
- 两面接触的高可靠性设计
- 连接简单的卡入方式

1.0mm
间距

■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20m Ω 以下
环境试验后/30m Ω 以下
- 绝缘电阻: 800M Ω 以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.33 $\pm$ 0.02 $\pm$ 0.03mm
- 适合的印刷电路板厚度: 0.8mm $\sim$ 1.6mm



FMSCONNECTOR

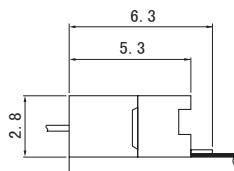
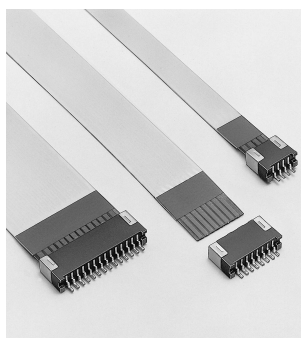
Non-ZIF SMT型

- 防止接插时翘起
- 两面接触的高可靠性设计
- 连接简单的卡入方式
- 封装厚度为2.8mm的紧凑设计

1.0mm
间距

■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20m Ω 以下
环境试验后/30m Ω 以下
- 绝缘电阻: 800M Ω 以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.30 $\pm$ 0.05mm



FPZCONNECTOR

ZIF SMT型

- 快速可靠的连接
- 高度为2.9mm的高密度设计
- 最适合表面封装的耐热设计
- 以塑封带装对应自动封装

1.0mm
间距

■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20m Ω 以下
环境试验后/30m Ω 以下
- 绝缘电阻: 800M Ω 以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.30 $\pm$ 0.05mm

